

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

20/8/03
2003016862(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2003年2月20日 (20.02.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/015147 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01L 21/304, B24B 37/04 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP02/07973 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大下 哲也 (OSHITA, Tetsuya) [JP/JP]; 〒113-8662 東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス9階 クラリアントジャパン株式会社内 Tokyo (JP). 相澤 雅美 (AIZAWA, Masami) [JP/JP]; 〒113-8662 東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス9階 クラリアントジャパン株式会社内 Tokyo (JP). 坂本 勝幸 (SAKAMOTO, Katsuyuki) [JP/JP]; 〒113-8662 東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス9階 クラリアントジャパン株式会社内 Tokyo (JP).
(22) 国際出願日: 2002年8月5日 (05.08.2002)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: 特願2001-236783 2001年8月3日 (03.08.2001) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): クラリアントインターナショナルリミテッド (CLARIANT INTERNATIONAL LTD.) [CH/CH]; CH-4132 ムッテンツ1、ロートハウスシュトラゼ61 Muttensz (CH). (74) 代理人: 吉武 賢次, 外 (YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

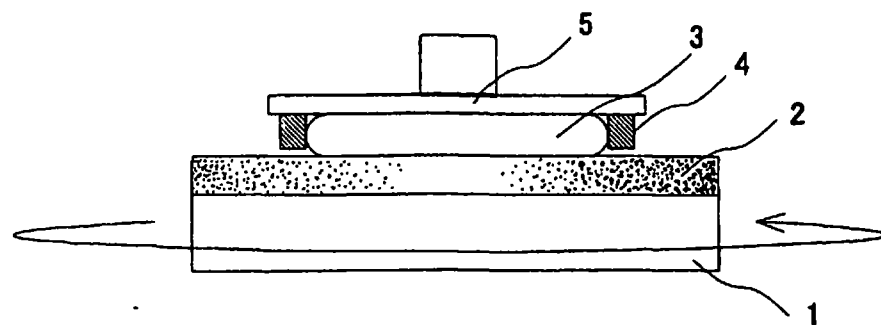
[続葉有]

(54) Title: WAFER HOLDING RING FOR CHEMICAL AND MECHANICAL POLISHER

(54) 発明の名称: 化学的機械的研磨装置用ウェハー保持リング



162162



(57) Abstract: A wafer holding ring for chemical and mechanical polisher for holding a wafer on a chemical and mechanical polisher capable of achieving the mass-production of polished wafers by preventing the wafer from being damaged, providing excellent wear resistance to the wafer, and reducing the times of replacement operations, characterized in that at least the surface of the wafer holding ring allowed to come into

contact with the wafer is formed of a resin composition containing at least 30 w.% or more of polybenzimidazole.

(57) 要約:

本発明はウェハーの破損を防ぎ、かつ耐摩耗性に優れ交換作業を減じることによる研磨ウェハーの量産化を達成することができる化学的機械的研磨装置用ウェハー保持リングの提供を目的とする。本発明の化学的機械的研磨装置用ウェハー保持リングは、化学的機械的研磨装置にウェハーを保持させるためのウェハー保持リングであって、ウェハー保持リングの、少なくともウェハーと接触し得る部分の表面が、ポリベンゾイミダゾールを少なくとも30重量%以上を含有する樹脂組成物からなることを特徴とするものである。

WO 03/015147 A1

(31) 指定国/国内: CN, KR, SG, US.

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(32) 指定国/広域: ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。